

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013年3月14日(14.03.2013)



(10) 国際公開番号

WO 2013/035625 A1

- (51) 国際特許分類:
B29C 33/38 (2006.01) B29C 45/26 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/072039
- (22) 国際出願日: 2012年8月30日(30.08.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-193355 2011年9月5日(05.09.2011) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ポリ
プラスチックス株式会社(Polyplastics Co., Ltd.)
[JP/JP]; 〒1088280 東京都港区港南二丁目18番
1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 宮下 貴之
(MIYASHITA, Takayuki) [JP/JP]; 〒4168533 静岡県
富士市宮島973番地 ポリプラスチックス株
式会社内 Shizuoka (JP). 廣田 晋一(HIROTA,

Shinichi) [JP/JP]; 〒4168533 静岡県富士市宮島97
3番地 ポリプラスチックス株式会社内
Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 正林 真之, 外(SHOBAYASHI, Masayuki
et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内1-7-
12 サビアタワー Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST,
SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, ZA, ZM, ZW.

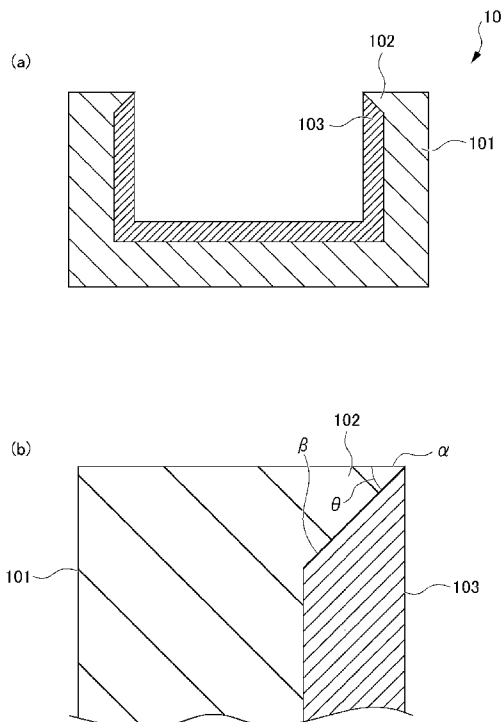
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,

[続葉有]

(54) Title: MOLD

(54) 発明の名称: 金型

[図2]



(57) Abstract: Provided is a technology that resolves defects such as cracking of a heat insulating layer resulting from the heat insulating layer formed at a first mold contacting a second mold at the mold mating surfaces. A mold is split into at least two pieces, a heat insulating layer is formed at approximately the entire inner wall surface, and the heat insulating layer is caused to not be present at the mating surfaces of the mold. For example, the mold is provided with a first mold constituting the majority of a cavity, and a second mold that forms at least a portion of the cavity together with the first mold; the first mold is provided with a flange section, and a portion of the surface of the flange section configures a portion of the mold mating surface.

(57) 要約: 金型の合わせ面において、第一金型に形成された断熱層が第二金型に接触することで、断熱層が欠ける等の不都合を解消する技術を提供する。二以上に分割された金型であって、内壁面の略全面に断熱層を形成し、金型の合わせ面には断熱層が存在しないようにする。例えば、キャビティの大部分を占める第一金型と、第一金型とともにキャビティの少なくとも一部を形成する第二金型とを備え、第一金型はフランジ部を備え、フランジ部の表面の一部が、金型合わせ面の一部を構成する金型である。

WO 2013/035625 A1



MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラ
シア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッ
パ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))